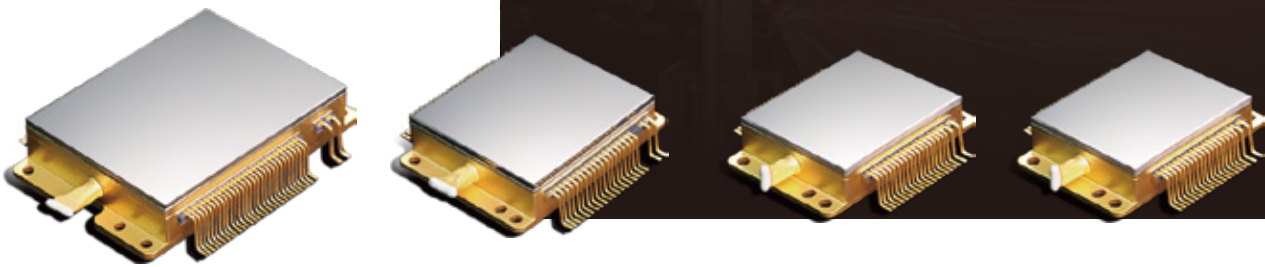


金属封装非制冷 红外探测器

经典的红外热成像解决方案



产品介绍：

作为技术成熟，性能稳定的非制冷红外探测器封装方式，金属封装依然是目前非制冷红外探测器市场的主流。灵敏度高，成像质量好，运行稳定可靠是金属封装探测器的优势所在，而且还可以适应多种极端恶劣环境，应用场所和行业领域也更宽泛。

为满足高要求检测而设计

- 灵敏探测，NETD低至30mK
- 内置TEC，工作稳定

适应各类极端环境

- 可靠性高，坚固耐用
- 适应性强，适用于各类极端环境

产品参数表

产品型号	GST1212M	GST817M	GST612M	GST417M
敏感材料	氧化钒			
阵列规格	1280×1024	800×600	640×512	400×300
像元间距	12μm	17μm	12μm	17μm
响应波段	8-14μm			
典型NETD	<50mK	<30mK	<40mK	<30mK
输出信号	内置14位ADC			
热响应时间	<12ms			
最大帧频	50Hz			
功耗	≤350mW	≤290mW	≤220mW	≤250mW
尺寸(mm)	45×28.5×8 (不计引脚尺寸)	35×25×7.4 (不计引脚尺寸)	30×19.8×7.32 (不计引脚尺寸)	30×19.8×7.32 (不计引脚尺寸)
重量	< 57g	<20g	<20g	<15g
工作温度	-40°C ~ +85°C			

规格如有变更，恕不另行通知

武汉高芯科技有限公司

☎ 400-027-0198

✉ marketing@gst-ir.com

🌐 www.gst-ir.com

📍 湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号,430205

